

# Корзина Для Очистки Пластин Из Высокочистого Птфэ, Устойчивая К Кислотам, Кассета Для Кремниевых Пластин, Стойка Для Травления Из Фторполимера

Артикул: PL-CP284



## введение

Обеспечьте отсутствие загрязнений при обработке полупроводников с помощью наших корзин для очистки пластин из высокочистого ПТФЭ. Разработанные для агрессивного травления и очистки, эти настраиваемые кассеты обладают исключительной химической стойкостью и термостабильностью при обращении с кремниевыми пластинами во время критических процессов мокрой химической обработки.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
<b>Стандартная очистка RCA</b>	Последовательные этапы очистки SC-1 и SC-2 для удаления органических остатков и металлических загрязнений с кремниевых пластин.	Предотвращает вымывание металлических ионов, обеспечивая ультрачистую среду обработки.
<b>Травление в «пирании»</b>	Использование смесей серной кислоты и перекиси водорода для удаления тяжелых органических материалов и фоторезиста.	Выдерживает экстремальные экзотермические реакции и агрессивное окисление без разрушения.
<b>Погружение/Травление в HF</b>	Удаление жертвенных оксидных слоев или естественных оксидов с помощью растворов плавиковой кислоты.	Полный иммунитет к воздействию HF, которое разрушило бы стеклянные или кварцевые кассеты.
<b>Текстурирование солнечных элементов</b>	Погружение кремниевых пластин в щелочные или кислотные растворы для создания светозахватывающих текстур поверхности.	Высокая производительность и стойкость к концентрированным растворам KOH или NaOH.
<b>Очистка после ХМП (CMP)</b>	Удаление частиц суспензии и химических остатков после химико-механической полировки.	Антипригарная поверхность предотвращает повторное осаждение суспензии на кассету и пластины.
<b>Фотолитография</b>	Этапы проявления и удаления фоторезиста с использованием агрессивных органических растворителей и проявителей.	Устойчивая к растворителям конструкция предотвращает разбухание или размягчение материала кассеты.
<b>Ультразвуковая очистка</b>	Высокочастотная акустическая очистка чувствительных электронных компонентов в водных растворах.	Эффективно передает ультразвуковую энергию, защищая компоненты от механического воздействия.
<b>Обработка GaAs</b>	Мокрое химическое травление и очистка подложек полупроводниковых соединений для оптоэлектроники.	Бережная, надежная поддержка хрупких подложек на критических этапах производства.
Параметр	Описание / Спецификация (Серия PL-CP284)	
<b>Артикул продукта</b>	PL-CP284	
<b>Основной материал</b>	Высокочистый первичный ПТФЭ (политетрафторэтилен)	
<b>Химическая совместимость</b>	Универсальная (Сильные кислоты, щелочи, растворители, окислители)	

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Параметр	Описание / Спецификация (Серия PL-CP284)	
<b>Стандартные размеры пластин</b>	Совместимость с пластинами 4, 6 и 8 дюймов	
<b>Варианты настройки</b>	Полностью настраиваемые размеры, количество пазов и ширина пазов	
<b>Конфигурации рукояток</b>	Фиксированные, съемные или совместимые с роботами стили (Настраиваемые)	
<b>Рабочая температура</b>	-200°C до +260°C (Непрерывно)	
<b>Отделка поверхности</b>	Высокоточная обработка на ЧПУ, мелкопористая поверхность	
<b>Конструкция паза</b>	V-образная или специальные профили для минимальной площади контакта	
<b>Производственный процесс</b>	100% обработка на ЧПУ для точности и структурной целостности	
<b>Уровень чистоты</b>	Класс для следового анализа, производство без металлов	